様

PCN-SM2116
2021年12月17日
富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社
品質保証部
部長　長沼裕之

Tube出荷品(SOP8_150mil)包装仕様の追加について

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、現在貴社にご採用いただいております製品につきまして、
納入時に使用する包装材の仕様を追加させていただきます。
変更内容は下記の通りとなりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

敬　具

― 記 ―

1．対象製品

SOP8（150mil）パッケージで、Tube包装形態で納入している製品。

MB85RC04PNF-G-JNE1、	MB85RC04VPNF-G-JNE1、	MB85RC128APNF-G-JNE1
MB85RC128PNF-G-JNE1、	MB85RC16PNF-G-JNE1、	MB85RC16VPNF-G-JNE1
MB85RC16VPNF-G-JNN1E1、	MB85RC1MTPNF-G-JNE1、	MB85RC256VPNF-G-JNE1
MB85RC512TPNF-G-JNE1、	MB85RC64APNF-G-JNE1、	MB85RC64PNF-G-JNE1
MB85RC64VPNF-G-JNE1、	MB85RS128APNF-G-JNE1、	MB85RS128BPNF-G-JNE1
MB85RS16NPNF-G-JNE1、	MB85RS16PNF-G-JNE1、	MB85RS1MTPNF-G-JNE1
MB85RS256APNF-G-JNE1、	MB85RS256BPNF-G-JNE1、	MB85RS512TPNF-G-JNE1
MB85RS64PNF-G-JNE1、	MB85RS64TPNF-G-JNE2、	MB85RS64TUPNF-G-JNE2
MB85RS64VPNF-G-JNE1		

2．追加内容

・Tubeの仕様追加
・防湿アルミラミネート袋の仕様追加
・湿度インジケーターの仕様追加
・内装箱の仕様追加

3．追加理由

対象製品の現行包装仕様は弊社専用仕様の為、現在の半導体市況で、安定した調達が難しくなっています。　その為、安定した製品納入を継続できるよう、委託先で汎用として使用している包装仕様も追加し、「現行仕様と追加仕様」の併用にて納入とさせていただきたく、ご理解とご協力をお願い致します。

4．追加予定時期

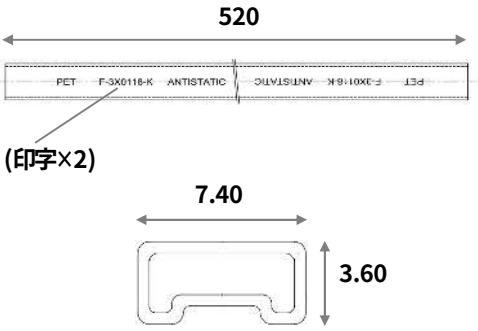
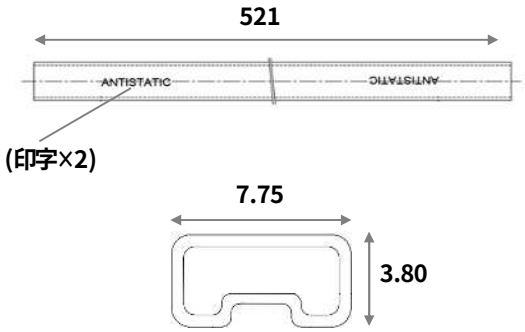
2022年3月中旬以降の納入より適用させていただきます。

5．追加する包装仕様

追加仕様については、次頁にあります現行仕様と追加仕様内容を参照願います。
なお、仕様追加による製品の品質、保証に変更はございません。

現行仕様と追加仕様内容（1/2）

□Ｔｕｂｅ　現行仕様と追加仕様

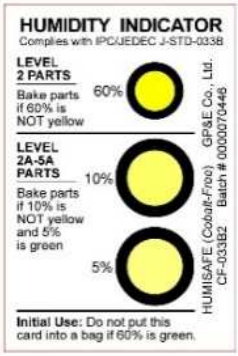
仕様	現行仕様	追加仕様
IC 収納数	95 個	95 個
外形サイズ	 3.60 × 7.40 × 520. mm	 3.80 × 7.75 × 521. mm
外観	 (印字) PET F-3X0118-K ANTISTATIC	 (印字) ANTISTATIC

□防湿アルミラミネート袋　現行仕様と追加仕様

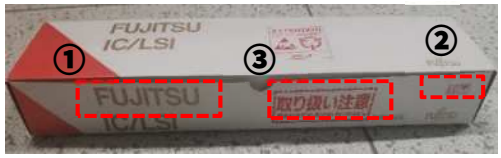
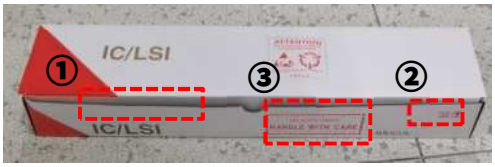
仕様	現行仕様	追加仕様
外形サイズ	幅:120, 長さ:750, 厚:0.09 mm	幅:222, 長さ:722, 厚 015mm
外観		

現行仕様と追加仕様内容（2/2）

□湿度インジケーター　現行仕様と追加仕様

仕様	現行仕様	追加仕様
検知湿度	30%	5% 10% 60%　（JEDEC 準拠）
外観		

□内装箱　現行仕様と追加仕様

仕様	現行仕様	追加仕様
外観サイズ	印字だけが異なります。 外形サイズに差異はありません。	
外観	上面 ① 側面 	上面 ① 側面 
	①FUJITSU ロゴあり ② FUJITSU マークあり ③ 取り扱い注意	① FUJITSU ロゴなし ② FUJITSU マークなし ③ DELICATE PARTS HANDLE WITH CARE

以上